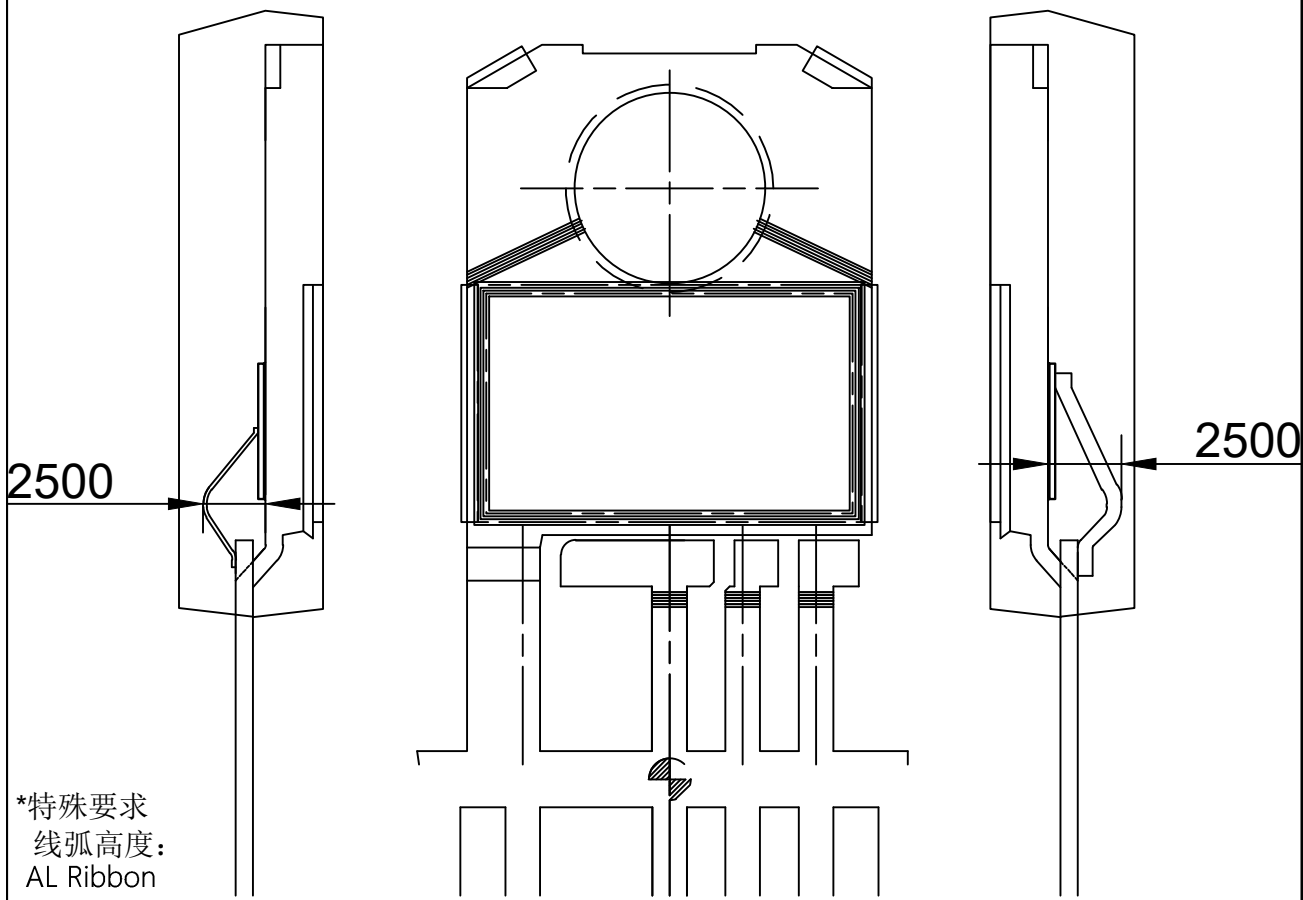




## 装片键合配线图

配线图号	版本号	封装外形	T0-247-4L
装片方向	引线框传输方向	客户回签	



\*特殊要求  
线弧高度:  
AL Ribbon  
CU Wire  $\leq 600\mu\text{m}$   
图纸坐标A, 坐标B公差 $\pm 50\mu\text{m}$

				封装信息			
成品名称				装片方式			焊线方式
芯片名称				框架型号			G极焊线
芯片尺寸 (um)	芯片厚度 (um)			框架镀层			S极焊线
G极尺寸 (um)	晶圆正面金属			基岛尺寸 (mm)	12.5 * 7.42	总线数	
切割道尺寸 (um)	晶圆背金			电镀方式	雾锡	制图日期	
线图来源				备注			
拟制		审核		批准		文控发行章	